

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 29 年 9 月 28 日 (2017.9.28)

【公開番号】特開 2016-181587 (P2016-181587A)

【公開日】平成 28 年 10 月 13 日 (2016.10.13)

【年通号数】公開・登録公報 2016-059

【出願番号】特願 2015-60630 (P2015-60630)

【国際特許分類】

H 0 5 K 9/00 (2006.01)

H 0 1 B 7/18 (2006.01)

H 0 1 B 7/20 (2006.01)

【F I】

H 0 5 K 9/00 L

H 0 1 B 7/18 D

H 0 1 B 7/20

【手続補正書】

【提出日】平成 29 年 8 月 21 日 (2017.8.21)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 3 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 3 5】

また、例えば、接続部材 3 の第一シールド部材 1 側の周面の第一層を構成する金属と第一シールド部材を構成する金属との標準電極電位差が、第一層以外の部分である第二層を構成する金属と第一シールド部材を構成する金属との標準電極電位差よりも小さいことも考えられる。この場合、第一シールド部材 1 と接続部材 3 との間の腐食を抑制できる。なお、第一層を、メッキ層と称してもよい。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 4 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 4 7】

また、本実施形態において、凹部 2 1 は、その深さが、第一シールド部材 1 の素線 1 0 の外径よりも小さい溝である。換言すれば、凸部 2 2 の深さが、第一シールド部材 1 の素線 1 0 の外径よりも小さい。この場合、接続部材 3 でかしめられる際に、凹部 2 1 に素線 1 0 全体がはまり、接続部材 3 で素線 1 0 が第二シールド部材 2 に押し付けられないといった状況を回避できる。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 5 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 5 2】

そして、接続部材 3 がかしめられることで第一シールド部材 1 と第二シールド部材 2 とが接続される。ここでは、図 4 に示されるように、接続部材 3 がかしめられることで、接続部材 3 の内周面によって押された素線 1 0 は、引き伸ばされ、凸部 2 2 間の凹部 2 1 側

に押し込まれる。